

株式会社ジェイ・イー・ティ

2023年12月期  
第3四半期決算説明資料

2023年11月14日

# 会社概要

# 会社概要

半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービスを展開



リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身  
**同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、**  
販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD. (以下、「ZEUS」)の全額出資のもと、  
2009.4.24に設立、2009.5に**エス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生**

## ■会社概要

会社名	株式会社ジェイ・イー・ティ
英訳名	J.E.T. Co., LTD.
設立	2009年4月
資本金	1,848百万円 (2023年9月30日時点)
所在地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
TEL	0865-69-4080
代表者	代表取締役社長 房野 正幸
従業員数	167名 292名 ※連結会社含む全従業員数 (2023年9月30日時点)
事業内容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・ アフターサービス等



**BW3000**  
バッチ式



**BW3700**  
バッチ式

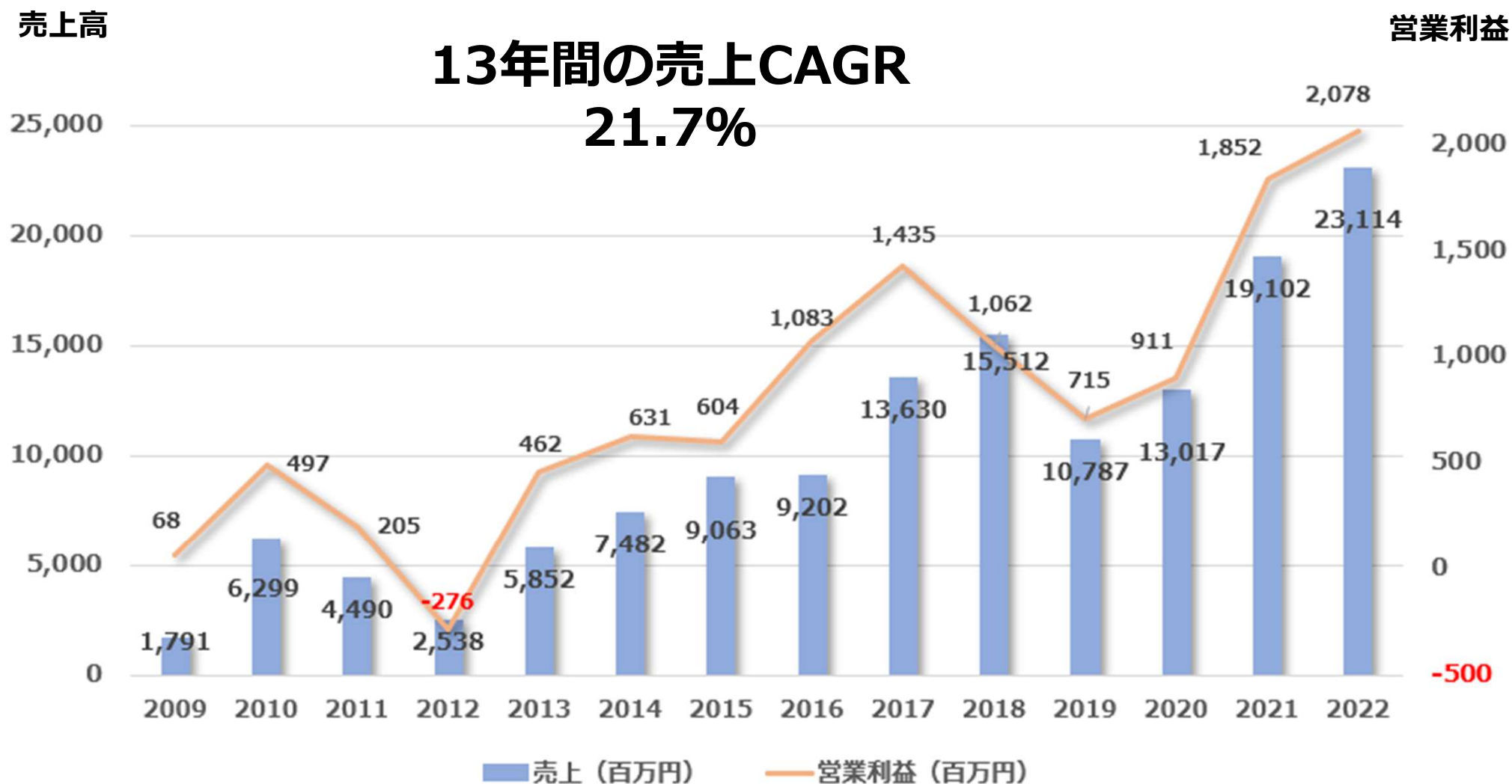


**HTS-300**  
枚葉式

# 連結長期業績（売上高・営業利益）推移

シリコンサイクルの影響は受けるものの、**半導体需要の増加に伴い成長**

売上高は2009年17億91百万円から2022年231億14百万円に成長（年平均成長率CAGR21.7%）



\* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

# グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



**所在地：** 大韓民国  
京畿道華城市

**資本金：** 5,192百万KRW

**事業の内容：** 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

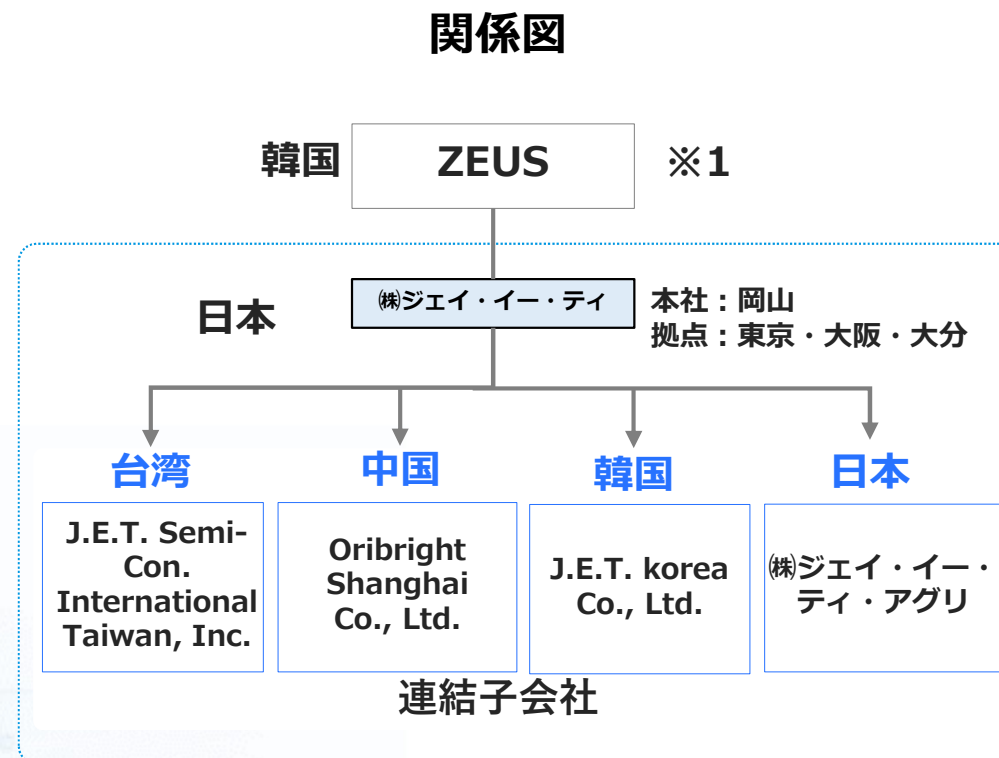
**当社の議決権の保有割合(%)：** 66.4% (直接)

**関連当事者との関係：** 営業取引

**取引の内容：** 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等

\* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

## 関係図



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

# 拠点

前身エス・イー・エス(株)時代からのアジア展開を更に**意識的に加速**、  
韓国・台湾・中国を中心に拠点網を展開

- 国内拠点
- 海外拠点



**韓国拠点  
19名**

J.E.T. Korea Co., Ltd.

- Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



**中国拠点 79名**

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.  
(Singapore branch) シンガポール支社

\* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

**シンガポール 3名**

大阪事務所(※2) 東京事務所(※1)

株式会社 ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※3)

九州出張所(※1)

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.  
(HEAD Office) 台湾本社



**本社 (岡山)**



**台湾拠点  
24名**

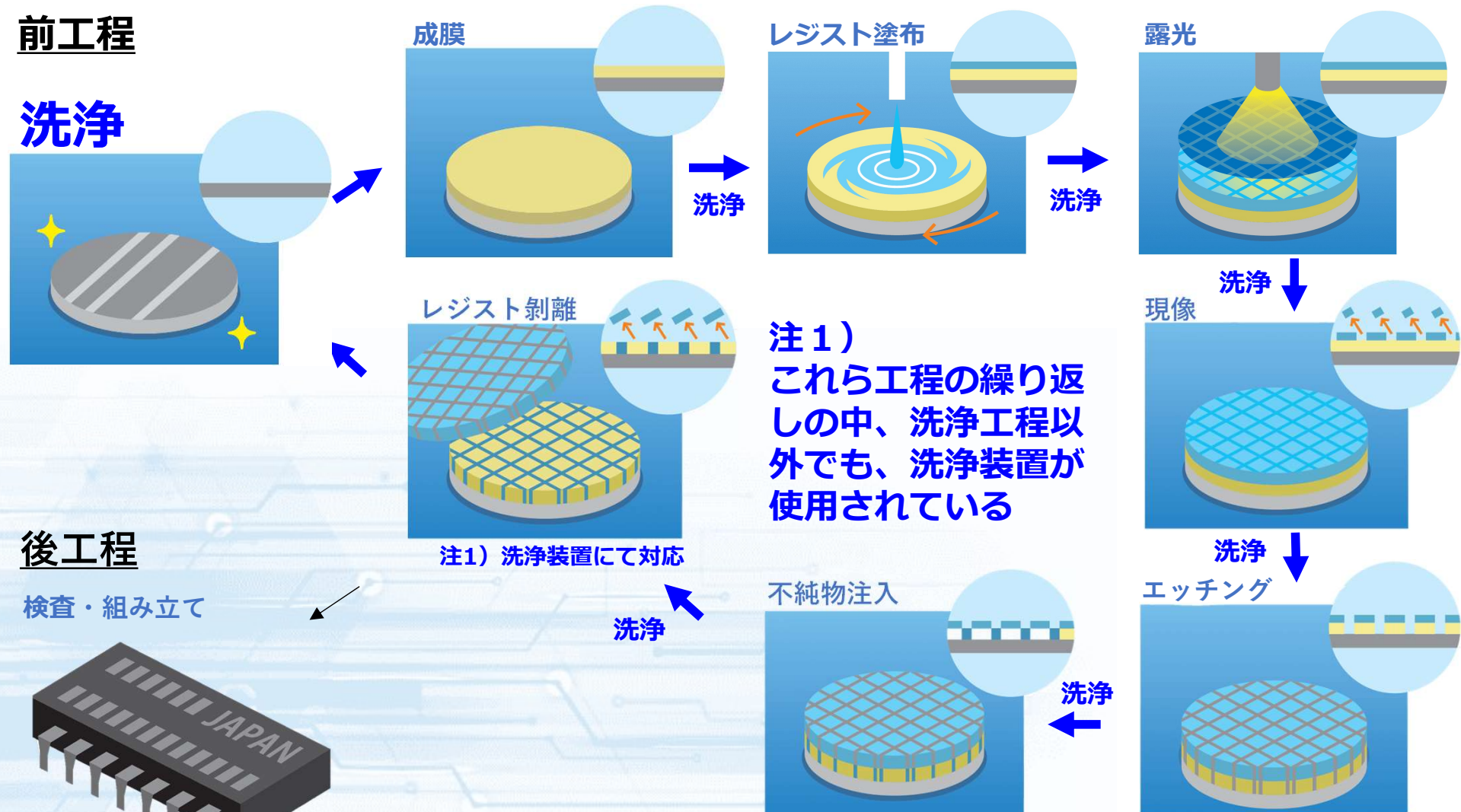
- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供しております。
- ※2 大阪事務所では、LIB製品の営業を行っております。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社である株式会社ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培しております。

# 半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程  
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

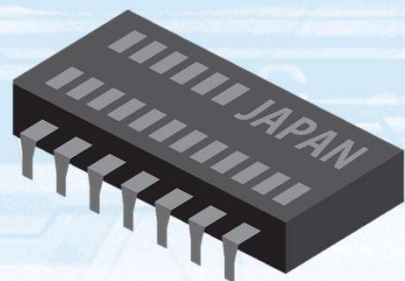
## 前工程

### 洗浄



## 後工程

検査・組み立て



# 半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社製品の特徴

洗浄には薬液を使用するウェット洗浄と酸素ガスやオゾンを用いるドライ洗浄の2種類が存在  
より多く使われているのはウェット洗浄。ウェット洗浄にはバッチ式と枚葉式が存在

	バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要	25～50枚のウエハをまとめて各処理槽にて処理する洗浄装置	ウエハを1枚ずつ処理槽内で処理する洗浄装置
長所	生産性が高い	一枚ずつ精密に制御した洗浄が可能
短所	ウエハの塵を拾い易い	生産性が落ちる
現状	一時期、枚葉式に置き換わるも、生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主要洗浄装置
当社製品の特徴	他社の標準化された製品と比較し、カスタマイズ性に優れ、洗浄槽の構成や設置数の変更が可能 F-Typeには唯一当社が対応	赤外線ランプでウエハ上の薬液を高温にするといった特殊な機能を搭載、処理性能を向上させ 使用薬液量も削減 高温・高粘度処理に優位性を持つ



# 競合状況と差別化要素① 競合先

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

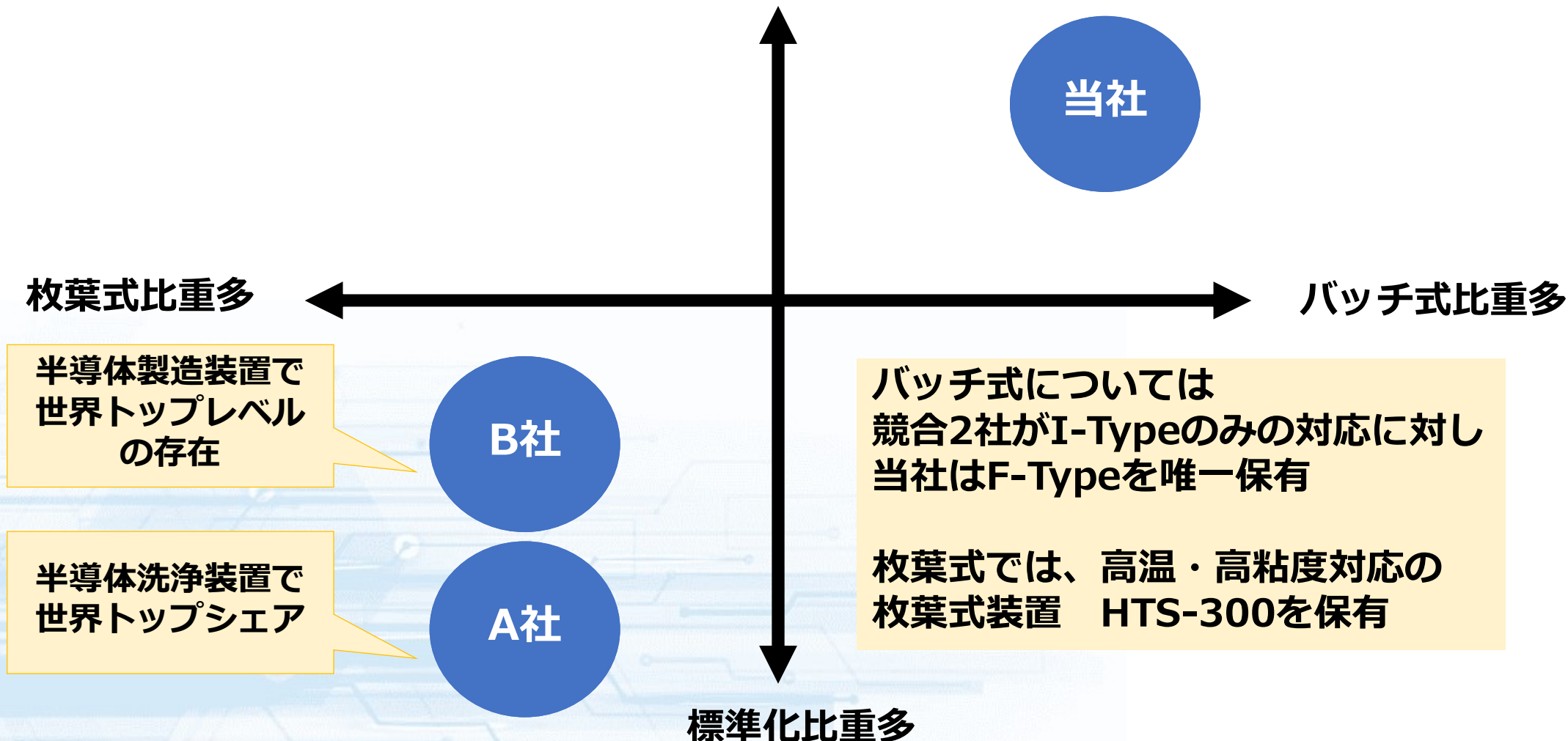
	概要	取扱製品の特徴	競合状況の分析
A社	半導体洗浄装置につき 世界トップシェア	枚葉式・バッチ式洗浄装置 共に世界トップシェア 標準化された装置に強み	半導体洗浄業界の最大手 標準化装置に強みを持つが、 当社主力ユーザーでの 競合は少ない
B社	半導体製造装置につき 世界トップレベルのシェア	半導体前工程で使用される装置 (WFE) 全体で世界トップレベルの シェア 枚葉式・バッチ式とも 高い技術力を持つ	主力ユーザーに対し、売り込み を強化しており、競合は発生 ただし、 機能による差別化が図れている
当社	韓国・中国・台湾を主体に 営業展開 ここ数年は中国市場に注力	バッチ式洗浄装置を得意とし、 連結売上の90%以上がバッチ式 枚葉式についても 一部特殊な装置に強み	

\* 上表の競合先及び当社に関する説明は、2023年6月時点での当社独自の認識による。

## 競合状況と差別化要素② ポジショニング

A社、B社の存在感は大きいですが、当社も市場で独自の立ち位置を占める

ニッチ対応多・カスタマイズ性多



注) 当社独自の認識に基づくイメージ図である。バッチ式推定世界シェアはSEMI販売統計、競合各社決算説明資料より当社推計

# 当社の特長と強み 5つのポイント

# 1

長い歴史に培われた  
海外大手顧客との信頼関係

# 2

アジア特化戦略により築いた  
アジアでのポジション・人脈

# 3

小回りの利く体制  
柔軟性・機動力  
カスタマイズ対応力

# 4

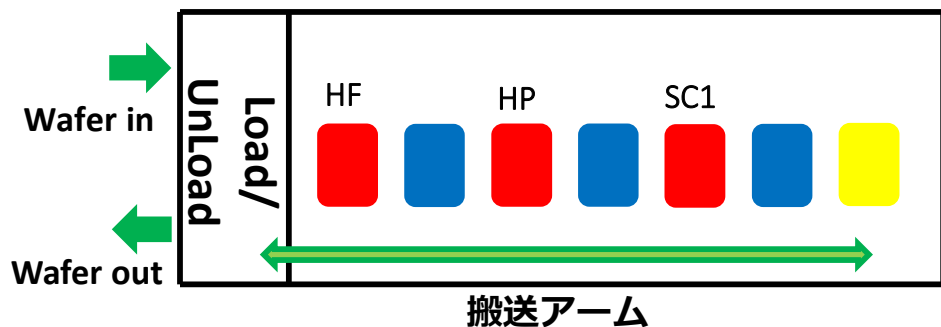
自動車・電機  
日本の産業の裾野の広さが  
育んだ優秀な  
外注先（協力会社）の活用

# 5

特定領域  
(高温・高粘度薬液対応等)  
での差別化された技術力  
経験知の蓄積

# JETバッチ装置の優位性 → 唯一F-Typeを持つ

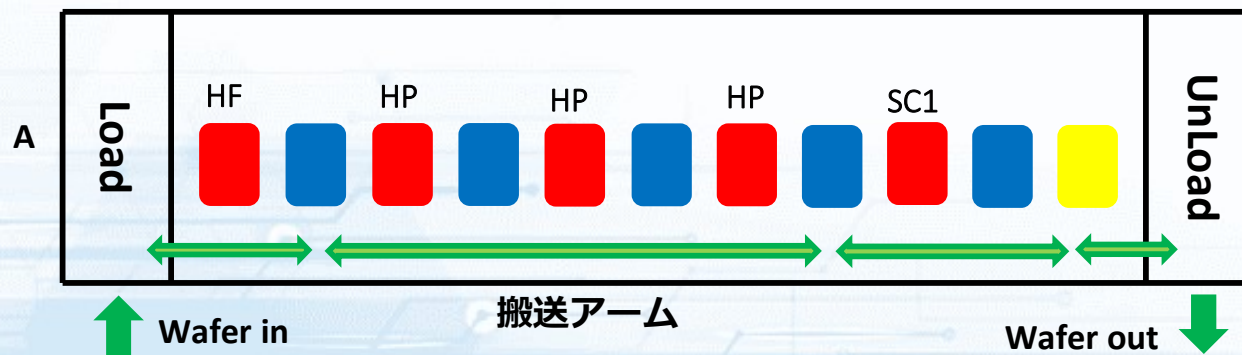
## I-Type A社 / B社 / 当社



### 特徴

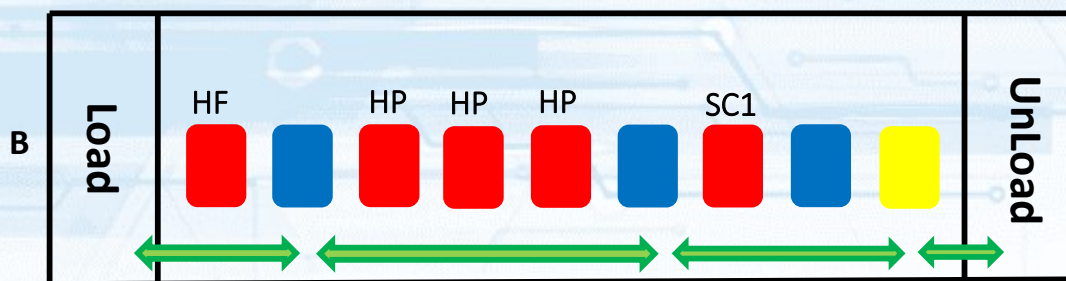
- コンパクト
- 処理槽 MAX 8 槽  
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- スループット 最大250w/h

## F-Type 当社のみ



### 特徴

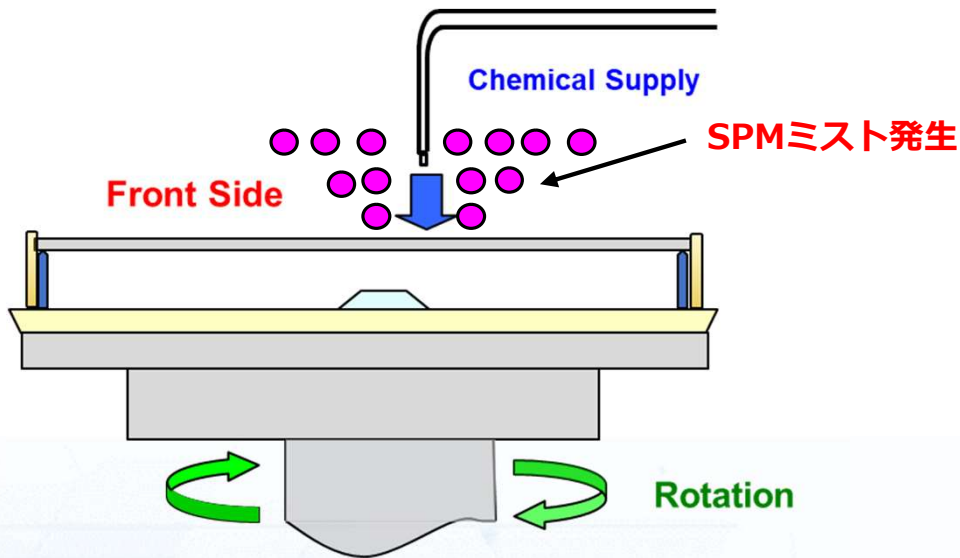
- 少し大きい
- 処理槽 MAX14槽  
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- A/B 選択可能
- Bはケミカル槽を連続配置可能
- 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- **スループット 最大 500w/h**



\* 2023年6月時点での当社独自の認識による。

# 当社 枚葉式装置の優位性

## A/B社 枚葉式SPM装置



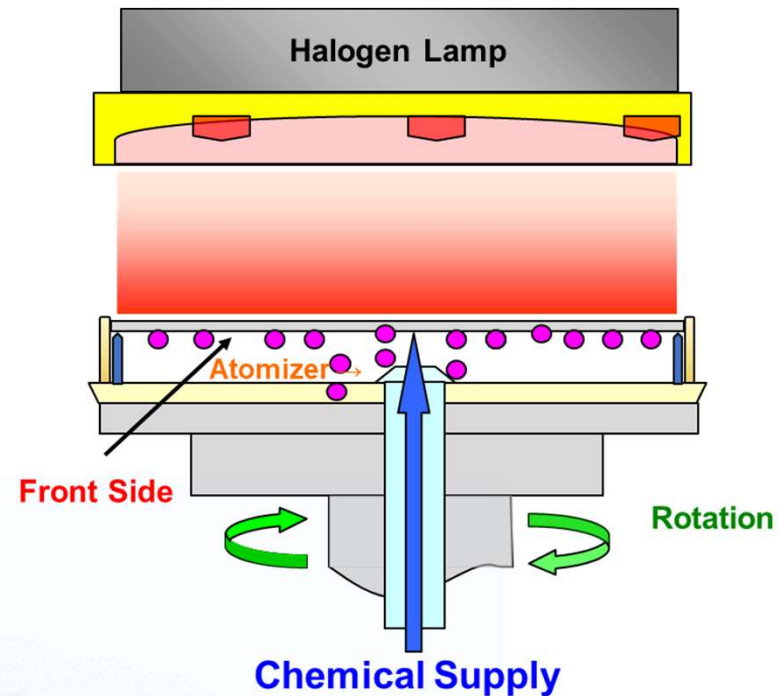
### 特徴

- 処理温度：150~200℃
- ケミカルの反応熱を利用
  - ➡ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- プロセス時間：5min/HDIレジストウエハ (注)
- ➡必要ケミカル量：3000ml/ウエハ  
(5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為)
- SPMミストによりパーティクル発生量が多い

\* HDIレジストウエハ=硬化層つきのレジストウエハ


\* 2023年6月時点での当社独自の認識による。

## 当社 枚葉式SPM装置 (HTS-300)



### 特徴

- 処理温度：200~240℃
- ハロゲンランプにて高温維持可能
- 処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用
- **プロセス時間：0.5min/HDIレジストウエハ**
  - ➡必要ケミカル量：150ml/ウエハ
- SPMミストが拡散せず、パーティクルの発生量が少ない

The background of the slide is a blue-toned image of a circuit board with various traces and components, overlaid with a semi-transparent blue rectangle containing the title text.

# 2023年12月期第3四半期連結決算概要 トピックス及び当面の目標

# 業績サマリー

受注環境は引き続き厳しいものの、豊富な受注残から3Qは増収増益  
半導体メーカーの工場立上遅延の影響なども想定し、4Qはやや慎重な見通し

<b>売上高</b> 19,726百万円	<b>営業利益</b> 2,064百万円	<b>経常利益</b> 1,872百万円	<b>当期純利益</b> 1,270百万円
前期比 +20.6%	前期比 +17.0%	前期比 +20.0%	前期比 +22.6%

- ✓ 世界的な消費減速の影響で引き続きメモリ価格は低迷、ロジック半導体、イメージセンサーなども調整局面
- ✓ 中国を中心とした成熟世代半導体向け設備投資は継続も、一部に投資減速の傾向

# 連結業績

3Qまでの進捗は順調も4Qについてはなお慎重、販管費を抑制

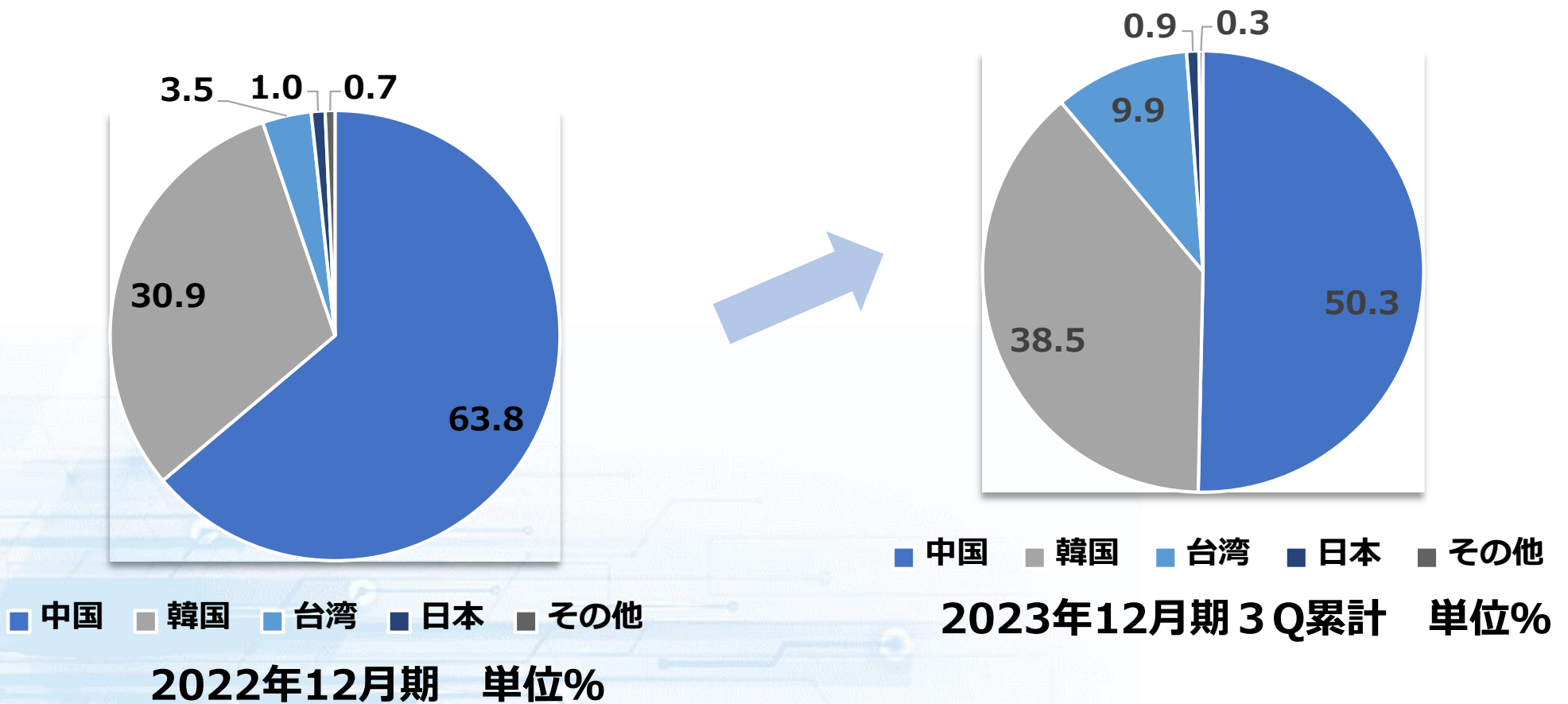
単位 (百万円)	2022年3Q	売上比 (%)	2023年3Q	売上比 (%)	対前期比 (%)	通期予想	進捗率 (%)
売上高	16,357	—	19,726	—	+20.6%	26,536	74.3%
売上総利益	3,824	23.4%	4,157	21.1%	+8.7%		
販管費	2,060	12.6%	2,093	10.6%	+1.6%		
営業利益	1,763	10.8%	2,064	10.5%	+17.0%	2,759	74.8%
経常利益	1,560	9.5%	1,872	9.5%	+20.0%	2,581	72.5%
当期純利益	1,036	6.3%	1,270	6.4%	+22.6%	1,747	72.7%

- ✓ 売上高は前期比20.6%増収、営業利益は17.0%、当期純利益は22.6%増益
- ✓ 韓国メモリメーカー向け洗浄装置の立上遅延の影響あるも、中国ファウンドリ向け等の洗浄装置の販売は好調
- ✓ 販管費の抑制に努める



# 地域別売上高構成比推移

3Q累計ながら前期に比べ中国の構成比が減少し、韓国・台湾の構成比が上昇



# 連結貸借対照表

単位（百万円）	2022年12月期	2023年3Q	増減	主な増減要因
流動資産	26,439	25,892	-547	
有形固定資産	1,137	1,011	-126	
無形固定資産	75	57	-18	
投資その他資産	639	754	115	
資産合計	28,290	27,715	-575	
流動負債	14,435	10,613	-3,822	短期借入金の減少
固定負債	5,514	5,028	-486	長期借入金の減少
負債合計	19,950	15,641	-4,309	
純資産合計	8,340	12,073	3,733	増資による資本金、資本剰余金の増加 利益剰余金の増加
負債純資産合計	28,290	27,715	-575	

# 通期決算予想

市場環境は引き続き厳しいものの、受注残をこなし目標達成へ向け全社取り組みを強化

<p><b>売上高</b> 26,536百万円</p> <p>前期比 +14.8%</p>	<p><b>営業利益</b> 2,759百万円</p> <p>前期比 +32.8%</p>	<p><b>経常利益</b> 2,581百万円</p> <p>前期比 +36.1%</p>	<p><b>当期純利益</b> 1,747百万円</p> <p>前期比 +45.9%</p>
---	---	---	--

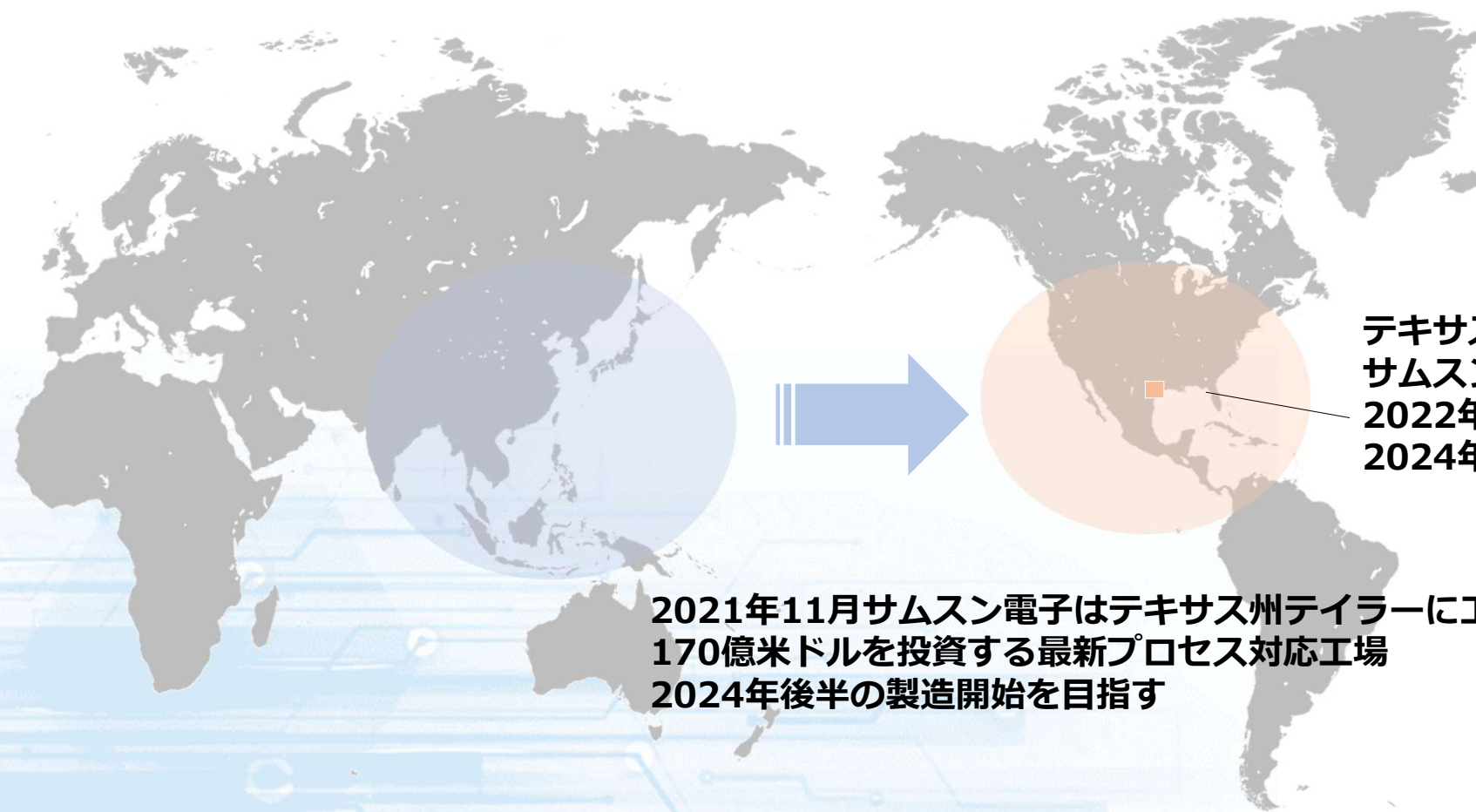


# 今後のビジネス展開

1. **安定・継続した成長の実現と利益率の改善**
2. **差別化された装置の開発による競争優位の実現**
3. **需要の増減に対応できる生産体制の構築**
4. **北米及び日本での新たな市場開拓**

# 北米での市場開拓

2024年稼働予定のサムスン電子テキサス・テイラー工場向け洗浄装置を既に受注  
この受注を足掛かりに拠点を開設、北米での顧客開拓を進める



テキサス州  
サムスン電子 テイラー工場  
2022年着工  
2024年稼働予定

2021年11月サムスン電子はテキサス州テイラーに工場建設を表明  
170億米ドルを投資する最新プロセス対応工場  
2024年後半の製造開始を目指す

# 米国子会社 (JET AMERICA INC.)

米国半導体産業の集積地であり、多額の設備投資が予定されているテキサス州ダラスに10月、半導体製造設備装置の販売・メンテナンス会社を設立、2024年1月より事業開始

テキサス州は、米国半導体開発・製造の大手  
テキサス・インスツルメンツ (TI) の拠点  
本社はダラス アナログICの最大手企業

地政学的要因を背景にCHIPS法など  
半導体産業の振興に注力する米国政府の方針も  
あり、今後大きな投資が予定されている

米国子会社は  
レガシー領域での顧客獲得にも注力



ダラス

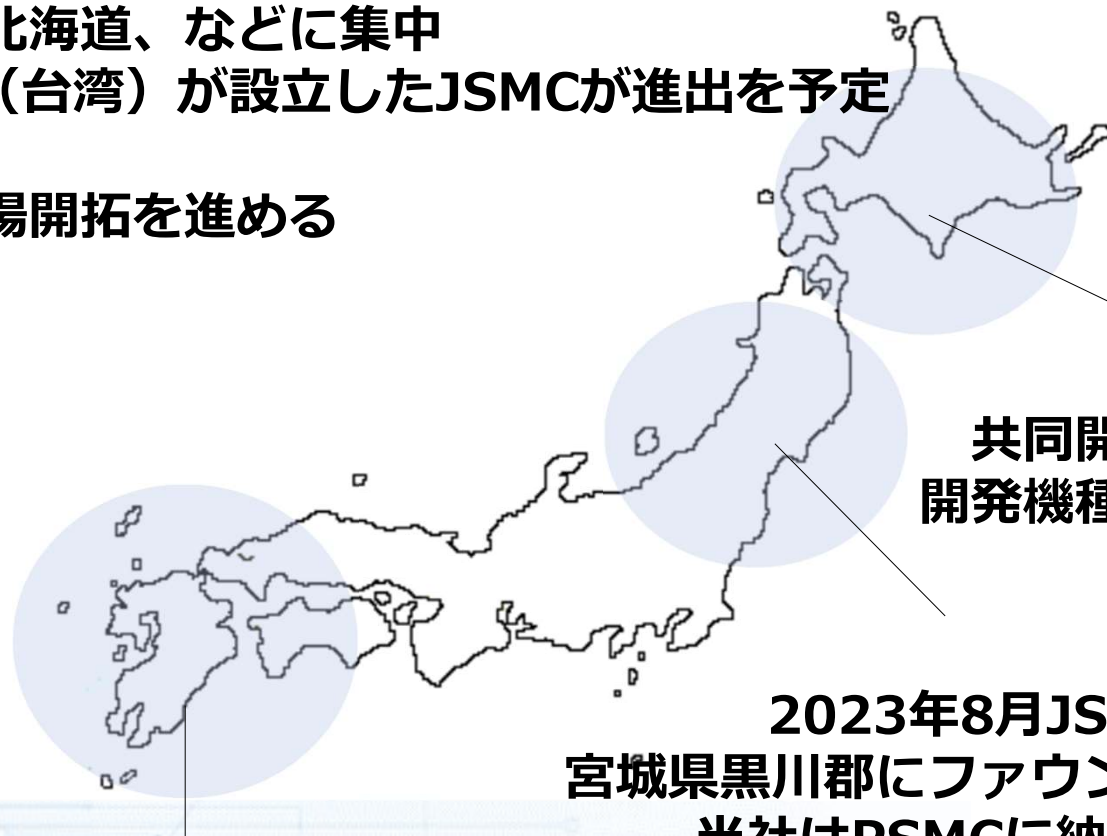
テイラー

オースティン

# 日本での市場開拓

地政学的な要因や政府の政策的挺入れもあり、  
半導体関連投資が九州、北海道、などに集中  
宮城県ではSBI・PSMC（台湾）が設立したJSMCが進出を予定

好機を逃さず日本での市場開拓を進める



枚葉式  
共同開発案件進行中  
開発機種種の横展開も模索

2023年8月JSMC設立  
宮城県黒川郡にファウンドリ建設を予定  
当社はPSMCに納入実績あり

様々な半導体関係の投資案件が集中

F-Typeなどの優位性を軸に  
顧客開拓を進める

## 当面の目標

利益率の向上が当面の最優先目標  
受注残を消化し、リードタイムの正常化を待って  
**利益率15%の早期達成**を目指す

- 施策
- ① 設計段階からの見直しを含むコストダウン対策強化  
→仕様から顧客ニーズを確認し、メーカー提案型にて  
仕様を検討するSD（システムデザイン）部新設
  - ② サプライチェーンの見直し

売上高231億円  
営業利益20億円  
営業利益率9.0%  
2022年12月期

300億円  
45億円  
営業利益率15%  
2027年までに達成



# 注意事項

## 本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2023年11月14日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しの変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

## 本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ  
経営企画室

TEL 0865-69-4281